2014 (3) العدد (36) العدد العلمية – سلسلة العلوم الأساسية المجلد (36) العدد (3) العدد المجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة العلوم الأساسية المجلد (36) العدد (3) العدد المحاف المحاف المحاف العلمية العلمية المحاف العلمية العلمية المحاف العلمية المحاف العلمية العلمية العلمية العلمية المحاف العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية المحاف العلمية المحاف العلمية المحاف العلمية العلمية المحاف العلمية العلمية العدد (3) العدد العلمية المحاف العلمية ا

تحديد ارتفاع حاجز شوتكى لديود ملدن وغير ملدن Ni – n-GaAs بوساطة المميزات السعوية (C-V)

الدكتور رزق محمد قرفول*

(تاريخ الإيداع 16 / 4 / 2014. قُبل للنشر في 26 / 6 /2014)

🗆 ملخّص 🗆

Ni-n- تمت في هذا البحث دراسة المميزات السعوية V-D لديودات شوتكي الملدنة و غير الملدنة من النوع – Ni-Ni عند درجة حرارة 300K قبل و بعد قذفها بطاقات ليزرية مختلفة. تمّ حساب تركيز الشوائب المانحة في قاعدة GaAs عند درجة حرارة 300K قبل و بعد قذفها بطاقات ليزرية مختلفة. تمّ حساب تركيز الشوائب المانحة في قاعدة الديود فكانت قيمها تتراوح بين 300k قبل و بعد قذفها بطاقات ليزرية مختلفة. تمّ حساب تركيز الشوائب المانحة في قاعدة تتراوح بين $^{-0.6}$

الكلمات المفتاحية: ديود شوتكي ملدن وغير ملدن ، المميزات السعوي V-C، جهد التماس، جهد الانحياز العكسي، تركيز الشوائب المانحة، ارتفاع حاجز شوتكي .

^{*}مدرس – قسم الفيزياء – كلية العلوم – جامعة تشرين – اللاذقية – سورية.

2014 (3) العدد (36) العدية – سلسلة العلوم الأساسية المجلد (36) العدد (3) العدد (3) العدد (3) Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Basic Sciences Series Vol. (36) No. (3) 2014

Determination Schottky Barrier Height for annealed and non-annealed Diode Ni-n-GaAs using The capacity-voltage characteristics C-V

Dr. Rizek Karfoul*

(Received 16 / 4 / 2014. Accepted 26 / 6 /2014)

\Box ABSTRACT \Box

In this research ,the characteristics C-V were studied for annealed and non- annealed Schottky diodes of Ni-n-GaAs type at 300K temperature before and after irradiation by different laser energies. Donor impurities concentration in the diode substrate was calculated and it ranged between $(0,63 \times 10^{15} - 0,65 \times 10^{15})$ cm⁻³ in non-annealed diodes. While it was ranged between $(1.08 \times 10^{15} - 0.94 \times 10^{15})$ cm⁻³ in annealed diodes. The capacity increased by the increase of the laser doses in the non-annealed diodes while it decreased in annealed diodes. In addition to, Schottky barrier height in non-annealed diodes was calculated and it ranged between (0.708 - 0.688)V. While in annealed diodes, it ranged between (0.79 - 0.87)V. Finally this height was calculated according to Schottky theory and the results were very close.

Key words: Annealed and non-annealed Schottky diode, capacity characteristics C-V, contact voltage, reverse bias voltage, donor impurities concentration, Schottky Barrier Height.

^{*} Assistant Professor, Department of Physics , Faculty of science, Tishreen University, Lattakia, Syria.

مقدمة:

يوجد استخدام كبير وواسع للمواد نصف الناقلة في الوقت الحاضر ، و خاصةً زرنيخ الغاليوم[1]GaAs في مجالات علمية كثيرة لما يتمتع به من منطقة محظورة عريضة مباشرة Eg=1.49eV تتصف بعملها في مجال حراري كبير خلافاً للسيلكون ذي المنطقة المحظورة الأقل عرضاً Eg=1.1eV[2,3]، وهذا يعني أفضلية GaAs لتمرير تيارات كبيرة ، وبدورها الأجهزة المستخدمة له تملك تيارات عكسية صغيرة وجهد أكبر [4] .

بناءً على ذلك اكتسبت التماسات بين المعدن و نصف الناقل اهتماماً كبيراً [5,6] بسبب التطبيقات المتزايدة له في مجال التقانات المتقدمة التي تملك القدرة على التحكم في ارتفاع حاجز شوتكي و بالتالي الارتقاء بالأجهزة الإلكترونية في أثناء التصنيع لتكون ذات أبعاد صغيرة و تؤدي وظيفة بأعلى جودة مثل الحساسات و الخلايا الشمسية و الكواشف الضوئية و الكواشف ذات الحاجز السطحي [7].

يوضح الشكل (1) مخطط سويات الطاقة لنصف الناقل و المعدن قبل التحام المعدن مع نصف الناقل وبعده .



شكل (1) : مخطط سويات الطاقة قبل تشكيل التماس معدن خصف ناقل(a) وبعد تشكيل التماس معدن – نصف ناقل (b) .

يسمّى حاجز شوتكي بحاجز الجهد الذي ينشأ في طبقة التماس السطحية (وعرضها X_{d}) الشكل (2) من نصف الناقل المجاور للمعدن بسبب فرق عمل خرج الالكترونات من المعدن Φ_{m} و عمل خرجها من نصف الناقل Φ_{s} [8].عند التماس بين المعدن و نصف الناقل من النوع n يكون لدينا ($\Phi_{m} > \Phi_{s}$) و يشحن المعدن بشحنات سالبة بينما يشحن نصف الناقل بشحنات موجبة ، وهكذا تنتقل الالكترونات بسهولة من نصف الناقل إلى المعدن أكثر منه في حالة التماس بين نصف الناقل من النوع p والمعدن حيث يكون لدينا ($\Phi_{m} < \Phi_{s}$) حيث يشحن المعدن بشحنات موجبة ونصف الناقل بشحنات موجبة ، عندما يحصل التوازن بين نصف الناقل والمعدن ينشأ فرق جهد تماسي $V_{\rm K}$ يعطى بالعلاقة[[9,10]:

(1)
$$V_{\rm ac} = \frac{(\Phi_{\rm m} - \Phi_{\rm g})}{q}$$

حيث q شحنة الإلكترون

وبسبب الناقلية الكبيرة للمعدن فان الحقل الكهربائي لا ينفذ منه ويزداد فرق الجهد التماسي المعدن فان الطبقة السطحية لنصف الناقل. إن اتجاه الحقل الكهربائي في هذه الطبقة هو بسبب أن طاقة حوامل الشحنة الأساسية فيها أكبر منه في كل سماكة نصف الناقل، هذا يعني أن السويات الطاقية عند حد التماس في نصف الناقل من النوع n تكون منحنية



شكل (2) : مخطط سويات الطاقة لتماس معدن – نصف ناقل نوع n في حالة التوازن الحراري .

يعطى ارتفاع حاجز شوتكي مي أجل نصف ناقل من النوع n وفقاً لنظرية شوتكي[11] بالعلاقة : $\Phi_{B} = \Phi_{m} - \chi$

حيث x هي الألفة الالكترونية لنصف الناقل (electronic affinity). إن ارتفاع حاجز شوتكي يتبع الحقل الكهربائي في نصف الناقل، وينخفض عند تطبيق جهد الانحياز العكسي v ، ويتبع أيضاً كثافة الحالات السطحية في نصف الناقل، و بما أنه لا يمكن التنبؤ بهذه الكثافة فإنه يجب قياس هذا الارتفاع تجريبياً . في هذا البحث قمنا باستخدام المميزات السعوية(C-V) عند تطبيق جهد انحياز عكسي v لقياس ارتفاع حاجز شوتكي.

يمكن إيجاد سعة ديود شوتكي عند تطبيق جهد انحياز عكسي V_R عليه [11,12] انطلاقا من معادلة بواسون : • ۹۸۵هـ = = ۹۸۵ • ۵۸

(donor impurities حيث \mathcal{E}_{s} السماحية الكهربائية لنصف الناقل ، N_{d} تركيز الشوائب المانحة concentration) في قاعدة الديود، X عرض منطقة النفاذ . بمكاملة معادلة بواسون مرتين نجد أن :

$$X = [2\mathcal{E}_{g}(V_{K} + V_{R})/qN_{d}]^{4/2}$$
(3)

$$: := \frac{S\mathcal{E}_{g}}{X} \text{ or } S\mathcal{E}_{g}(V_{K} + V_{R})/qN_{d}]^{4/2}$$
(4)

$$(4) \qquad (= S\mathcal{E}_{g}/[2\mathcal{E}_{g}(V_{K} + V_{R})/qN_{d}]^{4/2}$$
(5)

$$\frac{1}{2} \left[\frac{2(V_{K} + V_{R})}{q\mathcal{E}_{g}N_{d}S^{2}} - \frac{2(V_{K})}{q\mathcal{E}_{g}N_{d}S^{2}} + \frac{2(V_{R})}{q\mathcal{E}_{g}N_{d}S^{2}} \right]$$

حيث S مساحة المقطع العرضي للديود المدروس(مقطع منطقة التماس) ، وعند رسم الخط البياني 1/C² بدلالة V_R نحصل على مستقيم. نحدد من تقاطعه مع محور السينات الجهد V_K ، ومن ميله تركيز المانحات N_d بعد ذلك يحسب ارتفاع حاجز شوتكي من العلاقة :

> $\Phi_{\overline{s}} - \Phi_{n} + V_{K} + \frac{\kappa T}{q}$ (6) $\epsilon_{n} = \frac{\kappa T}{q} \ln \frac{N_{C}}{N_{d}}$ (7)

حيث Ne كثافة الحالات الفعّالة في قطاع الناقلية لنصف الناقل، K ثابت بولتزمان، T درجة الحرارة المطلقة .

أهمية البحث وأهدافه:

الهدف من هذا البحث:

1-دراسة العلاقة بين سعة الديود C و جهد الانحياز العكسي المطبق عليه V_R قبل وبعد قذفه بطاقات ليزرية مختلفة تتراوح بين V_R و. 0.2 kW/cm² والتعرف على الاختلاف المتوقع في السعة بين الديودات الملدنة وغير الملدنة ومحاولة تفسير ذلك بالمقارنة مع بعض المراجع [11,12,13].

2− تحديد ارتفاع حاجز شوتكي تجريبيا باستخدام المميزات السعوية V−V لديود غير ملدن و أخر ملدن عند درجة حرارة 300K ومن ثمّ دراسة التغير الحاصل له بعد قذف الديودات بطاقات ليزرية مختلفة .

3 – حساب تركيز الشوائب المانحة N_d الموجودة في قاعدة الديود قبل و بعد القذف بالليزر للديودات المدروسة والتعرف على التغير الحاصل.

تأتي أهمية هذا البحث من خلال الاستخدامات الكبيرة والواسعة لديودات شوتكي في كثير من الأجهزة الالكترونية البسيطة والمعقدة وهذا ما يتطلب المزيد من الأبحاث بهدف الوصول لأفضل النتائج .

طرائق البحث ومواده:

أجريت القياسات على ديود شونكي قاعدته من زرنيخ الغاليوم GaAs من النوع n مساحتها 0.1cm² تتوضع عليها طبقة من النيكل Ni بسماكة 1.3μm، من أجل جهود انحياز عكسية تتراوح بين V(7 – 0) عند تردد 10kHz .

تم تلدين بعض النماذج بعد تحضيرها في فرن عند درجة حرارة 2°450 لمدة عشر دقائق، ثمّ قذفت الديودات الملدنة و غير الملدنة بأشعة ليزرية نبضية طول موجتها 1.06μm وزمن النبضة sec.

حصلنا على هذه العينات من مخابر جامعة سانت بطرسبورغ التقانية الحكومية في مدينة سانت بطرسبورغ في

روسيا الاتحادية وأجريت القياسات في مخابر جامعة تشرين في المدة الواقعة بين 1-1-2013و 31-1-2013 م

عند دراسة المميزات V−V استخدمت الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل (3) .



شكل (3) :A مقياس ميلى أمبير V مقياس فولت C مقياس السعة .

النتائج والمناقشة:

قمنا بقياس السعة من أجل جهد انحياز يتراوح بين V(7 – 0) لديود غير ملدن ثمّ قذف بطاقات 0.2kW/cm² وقيست السعة من جديد فحصلنا على القيم الموضحة في الجدول (1).

				•		. 0	
7	6	5	4	3	2	1	جهد الانحياز العكسي (V _R (V
256	273	296	330	373	443	587	سعة النموذج قبل القذف بالليزر (C(PF
258	276	299	333	375	447	598	سعة النموذج C(PF) بعد القذف 0.2kW/cm ²
260	280	303	336	379	452	609	سعة النموذج(C(PF) بعد القذف 0.3kW/cm ²

جدول (1) :يتضمن قيم سعة الديود غير الملدن قبل و بعد قذفه بطاقات ليزرية مختلفة .



شكل(4) : المميزات C–V لديود غير ملدن قبل وبعد القذف بالليزر عند 300K.

يلاحظ من الشكل (4)التزايد في قيم هذه السعة مع زيادة طاقة الجرعات الليزرية بين 2 (4.0 – 0.2) التي تعرض لها الديود مما يشير إلى تزايد في تركيز الشوائب المانحة على حدود منطقة التماس بين المعدن ونصف الناقل وهذا ما يوضحه الجدول (2) . ولمّا كان هذا التزايد في السعة طفيفاً ،ولكي نتعرف بشكل أكبر على التغير الحاصل لسعة الديود نعرّف عامل الانحراف المعياري السعوي كما يأتي:

$$\Delta = \frac{\left| \vec{C} - C \right|}{C}$$

حيثC سعة الديود قبل القذف بالليزر و C سعة الديود بعد القذف بالليزر بطاقات ليزرية مختلفة ،واستناداً إليه نحصل على الشكل(5) الذي يوضّح أن السعة تتزايد مع زيادة طاقة الجرعات الليزرية، فضلاً عن أن سلوك الانحراف السعوي هو سلوك طيفي و ليس خطياً .



شكل(5) : عامل الانحراف السعوي بدلالة جهد الانحياز لديود غير ملدن قبل القذف بالليزر وبعده عند 300K

أجريت القياسات نفسها على نماذج ملدنة قبل القذف بالليزر وبعده . يوضح الشكل (6) التغير في سعة الديود الملدن، حيث يلاحظ أن سعة الديود تتاقصت بشكل واضح مع زيادة طاقة الجرعات الليزرية، وهنا تمكناً من قياس سعة الديود عند جرعة ليزرية قيمتها 0.4 kW /cm² خلافاً للنماذج غير الملدنة التي لم نتمكن من قياس سعتها عند تلك الجرعة ويعزى ذلك إلى زيادة المقاومة السطحية للنماذج الملدنة ،كذلك تبين أن تركيز الشوائب المانحة على حدود منطقة التماس بين المعدن ونصف الناقل قد تزايدت كما هو مبيّن بالجدول(2) .



شكل(6) : العلاقة بين السعة وجهد الانحياز العكسي لديود ملدن قبل القذف بالليزر ويعده عند 300K .

وبشكل مشابه فان الشكل(7) يوضّح أن سعة الديود الملدن تتناقص مع زيادة طاقة الجرعات الليزرية ، فضلاً عن أن سلوك الانحراف السعوي هو سلوك لا خطى .



شكل(7) : عامل الانحراف السعوي بدلالة جهد الانحياز لديود غير ملدن قبل وبعد القذف بالليزر عند300K .

لإيجاد ارتفاع حاجز شوتكي تمّ رسم المنحني البياني الذي يمثل 11/6² بدلالة جهد الانحياز العكسي V_R .



شكل(8) : العلاقة بين 1/1² وجهد الانحياز العكسي V_R لديود غير ملدن قبل القذف بالليزر وبعده عند 300K

رسم الشكل (8) من أجل ديود غير ملدن ،ويلاحظ منه تتاقص الميل m مع تزايد طاقة الجرعات الليزرية ،ومن الميل تم حساب تركيز الشوائب المانحة N_d من العلاقة := 1 من العلاقة من العلاقة الميل تم حساب تركيز الشوائب المانحة N_d من العلاقة الع

وكان جهد التماس V_K الناتج من تقاطع هذه المستقيمات مع محور السينات يتراوح بين 0.45V- و-وكان جهد التماس V_K الناتج من تقاطع هذه المستقيمات مع محور السينات يتراوح بين 0.45V- و-0.47Vكما هو موضح في الجدول (2)، وبمعرفة V_Kيمكن حساب ارتفاع حاجز شوتكيφ من العلاقة(6) بعد حساب Φ_n من العلاقة(7) .

ارتفاع الحاجز	جهد التماس	تركيز الشوائب المانحة	الميل	النموذج
Ф _в (V)	V _κ (V)	N _d (cm ⁻³)	$(F^{-2}V^{-1})$	
0.7089	-0.477	0.63×10^{15}	2.06×10 ¹⁸	قبل القذف بالليزر
06998	-0.4692	0.64×10^{15}	2.03×10 ¹⁸	0.2 kW/cm $^{-2}$ بعد القذف
0.6880	-0.4578	0.65×10^{15}	1.99×10 ¹⁸	بعد القذف 0.3kW/cm ⁻²

جدول (2) : يتضمن الميل، تركيز الشوائب المانحة، جهد التماس، وارتفاع حاجز شوتكي .

يحتوي الجدول(2) قيم ارتفاع حاجز شوتكي لنماذج غير ملدنة حيث يلاحظ أن هذه القيم تتناقص من 0.70V إلى 0.68V مع زيادة طاقة الجرعات الليزرية المطبقة .



شكل(9) : العلاقة بين 11/2 وجهد الانحياز العكسى V_R لديود ملدن قبل القذف بالليزر وبعده عند 300K .

رسم الشكل (9) من أجل ديود ملدن قبل قذفه بطاقات ليزرية مختلفة وبعده ، حيث نجد أن ميل الخطوط البيانية يتزايد بزيادة طاقة الجرعات الليزرية ووجدنا أن تركيز الشوائب المانحة يتناقص أما ارتفاع حاجز شوتكي فقد تزايد أيضاً من 0.79Vإلى0.79V كما هو موضح بالجدول (3) .

ارتفاع الحاجز	جهد التماس	تركيز الشوائب المانحة	الميل	النماذج
Ф _в (v)	V _κ (V)	N _d (cm ⁻³)	$(F^{-2} V^{-1})$	
0.8315	0.6145	1.0866×10 ¹⁵	1.191×10^{18}	قبل القذف بالليزر
0.7990	0.5800	0.99x10 ¹⁵	1.302×10^{18}	بعد القذف 0.2kW/cm ⁻²
0.8523	0.6323	0.97×10^{15}	1.333×10 ¹⁸	بعد القذف 0.3kW/cm ⁻²
0.8760	0.6550	0.94×10^{15}	1.375×10^{18}	بعد القذف 0.4kW/cm ²

جدول (3) :يتضمن الميل ، تركيز الشوائب المانحة ، جهد التماس ، وارتفاع حاجز شوتكي .

يعزى السبب في زيادة تركيز الشوائب المانحة للديودات غير الملدنة باعتقادنا إلى الاندماج المثالي لذرات النيكل في الشبكة البلورية لزرنيخ الغاليوم وهذا يكسب الديود مقاومة سطحية صغيرة مما يؤدي إلى تزايد سعة الديود بزيادة طاقة الجرعات الليزرية المطبقة عليه، وبعد تلدين هذه الديودات تزداد المقاومة السطحية للديودات نتيجة انخفاض حركية الالكترونات الحرة مما يؤدي إلى تناقص سعة الديود بزيادة طاقة الجرعات الليزرية المطبقة وبالتالي إلى تناقص تركيز الشوائب المانحة .

> يمكن حساب ارتفاع حاجز شوتكي انطلاقاً من نظرية شوتكي[1,4,9] وفقاً للعلاقة (2) : فنجد أن : 44% هو هو هو

حيث أن عمل خرج الالكترونات من النيكل هو : $\Phi_{NI} = 4.91V$ والألفة الالكترونية لزرنيخ الغاليوم هي : • X_{GEAS} = 4.07V .

إن هذه القيمة قريبة جداً من القيم التجريبية المحسوبة في هذا البحث. أما لو افترضنا أن الحالات السطحية هي التي تحدد قيمة ارتفاع حاجز شوتكي[10] فإننا نجد أن هذا الارتفاع B =2/3 Eg =0.95V و هي قيمة أكبر من القيم المحسوبة للنماذج الملدنة و غير الملدنة مما يدل على أن الحالات السطحية ليست هي السائدة في نماذجنا بل هي حالات المراكز العميقة في طبقة التماس بين المعدن و نصف الناقل وهذا ما سنحاول دراسته في أبحاث قادمة.

الاستنتاجات والتوصيات :

 إن المميزات V – V للنماذج غير الملدنة والمقذوفة بالليزر أظهرت تزايداً بسيطاً في سعة الديود مع زيادة الجرعات الليزرية غير أن هذه المميزات أظهرت انخفاضاً واضحاً في سعة الديود للنماذج الملدنة عند درجة حرارة 300K .

تبين لنا أن تركيز الشوائب المانحة في قاعدة الديود تزايدت في النماذج غير الملدنة بينما انخفضت في النماذج الملدنة .

إن دراسة العلاقة بين ²/1 و V_R تظهر تناقص الميل بالنسبة للنماذج غير الملدنة و تزايده للنماذج الملدنة
 أما ارتفاع حاجز شوتكي فقد انخفض في النماذج غير الملدنة مع تزايد الجرعات الليزرية وارتفع في النماذج الملدنة.

 هذه الدراسة تظهر أن الحالة السائدة للنماذج المدروسة ليست سطحية إنما هي حالة المراكز العميقة التي تتطلب منا دراسة جديدة في المستقبل .

• يمكننا متابعة هذا العمل لاحقاً بدراسة الخواص الكهربائية لهذه الأنواع من الديودات .

المراجع:

- [1]FUGIEDA,S. "Control of GaAsSchottky barrier height by formation of a thin offstoichiometric GaAs interlayer grown by low-temperature molecular beam epitaxy," Applied Physics Letters, vol. 61, no. 3,(1992), pp. 288–290,.
- [2]ALAA EL-DINSAYED HAFEZ and MOHAMED ABD EL-LATIF: Optimum Barrier Height for SiCSchottky Barrier Diode, IEEE Alexandria University, Alexandria 21913, Egypt, Received 4 April (2013); Accepted 13 June (2013).
- [3] YI-WEI LIAN, YU-SYUAN LIN, JUI-MING YANG, AlGaN/GaNSchottky Barrier Diodes on Silicon Substrates With Selective Si Diffusion for Low Onset Voltage and High Reverse Blocking, IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, VOL. 34, NO. 8, AUGUST (2013).
- [4] HUSSAIN, M. Y. SOOMRO, N. BANO, O. NUR, and M. WILLANDER: Systematic study of interface trap and barrier in homogeneities using I-V-T characteristics of Au/ZnOnanorodsSchottky diode, J. Appl. Phys, 113, 234509,(2013).
- [5] Г.С.АЛТЫБАЕВ;С.Е.КУМЕКОВ;А.А.МАХМУДОВ. Энергетическое распределение неравновесных электронов и оптических фононов в GaAs при межзонном поглощении мошных коротких импульсов света, физика и техника полупроводников, том 43, вып.3, (2009).

- [6]И.Г.АТАБАЕВ,Н.А.МАТЧАНОВ,М.У.ХАЖИЕВ,В.ПАК,Т.М.САПИЕВ, влияние раэличных химическых обработок поверхности на высоту барьеровАl-p-SiGe,Au-n-SiGe,физика и техника полупроводников,том 44,вып.5,(2010).
- [7] Г.А.БОРДОВСКИИ, С.А.НЕМОВ, Н.И.АНИСИМОВА, И.А.ДЗЕМИДКО, А.В.МАРЧЕНКО, П.П.СЕРЕГИН, Фотостуктурные перестроения полупроводниковых стыкол As-SU As-Se, физика и техника полупроводников, том 43, вып.3, (2009).
- [8]С.Ю.ДАВЫДОВ,А.А.ЛЕБЕДЕВ, О.В.ПОСРЕДНИК, Ю.М. ТАИРОВ, Контакт металл-карбид кремния : зависимость высоты барьера шоттки от политпаSiC,.физика и техника полупроводников, том 35, вып. 12, (2001).
- [9] SZE,S. M "Physics of semiconductor devices",(1981).
- [10]DONALD, A. NEAMEN, "Semiconductor physics and devices ",(1997).
- [11]ISMAIL K. ABBAS and ZAHRAA H. AHMED, *Study of the Electrical Characteristics ofSchottky Organic Semiconductor (n-Malachite green), Diode*,J. Alrafidain Sciences, vol.22, no.3,(2011),pp.111-121.
- [12]NAWAF YOUSIF JAMIL and MOHAMMED NOOR KHADER, Effect of Gamma Rays onSchottky Diodes of Au/n-Si type, Jordanian J. for Phys. Vol.5, no. 3,(2012), pp.149-157.
- [13] MOONGYU JANG and JUNGHWAN LEE," Analysis of Schottky barrier height in small contacts using a Thermionic- field emission model" ETRL Journal, volume 24 Number6, December (2002).